

電解Ni・Pd・Auめっき

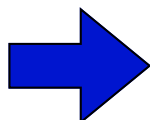
要旨

Pdめっきについては、下地の拡散防止バリア層として性能が非常に優れています。
電解Auめっきを多く取り扱う弊社では、ニーズにお応えすべく電解Ni・Au・Pdめっき工法を確立いたしました。

無電解めっきのデメリットは電解で解決

＜無電解めっきのデメリット＞

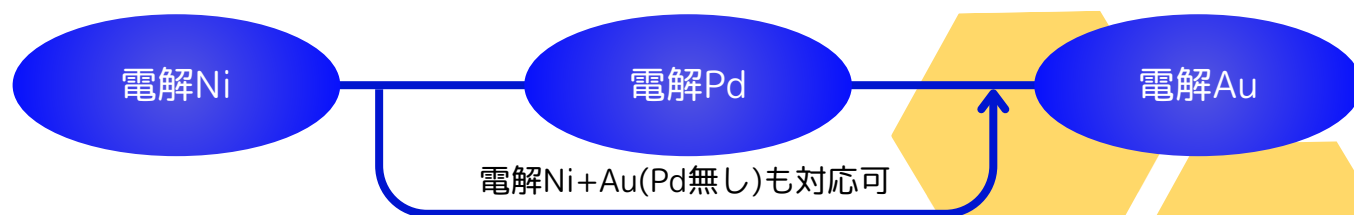
- ・ 膜厚の厚付けができない
- ・ 液更新による材料ロスが発生する
- ・ 処理時間が長く生産性が悪い
- ・ 下地の無電解Niの仕様に制限がある



＜電解めっきのメリット＞

- ・ 膜厚に制限がなく処理が可能
- ・ 材料ロスが少なくランニングコストが安い
- ・ 処理時間が短く、生産性向上と加工費削減が可能
- ・ 下地に制限がなく、Ni以外も含め選択が可能

めっき仕様



特徴と膜厚

	電解Ni	電解Pd	電解Au
特徴	非磁性目的で下地可能 Cuめっきでも対応可能	耐熱による下地Ni層の 拡散防止(バリア層)	WB性・はんだ接合性が良好 ※半導体部品に適したAuめっきです
膜厚	制限なし	要求仕様による対応可能	制限なし

対象物

- 製品事例 : 各種基板/接点部品/ガラスハーメ品/複合部品 等
対象物の材質 : Cu系/Fe系/SUS系/アルミ/Mo/W/Ti/メタライズ(スパッタ・ロウ付け品)等
独自技術 : 弊社固有のめっき技術で、アルミ、SUS、難素材(Mo・W等)を下地めっきすることが可能



～ 不可能への挑戦 ～

株式会社 友電舎
大阪市此花区常吉2-4-8
TEL : 06-6465-1663
e-mail : info@ydn.co.jp
URL : <http://www.ydn.co.jp>